

檔		保存年限
號	/	/

駐美國代表處經濟組 函

機關地址：4301 Connecticut Ave., N.W.
Suite 420, Washington, D.C.
20008, USA

承辦人：侯文革
電話：202-686-6400#5712
Email：wphou@moea.gov.tw

受文者：經濟部國際貿易局

發文日期：中華民國110年3月11日
發文字號：經美字第1100000287號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（經美1100000287_Attach1.pdf）

主旨：陳報有關美商務部就檢視美國「半導體製造及先進封裝供應鏈風險」徵求公眾評論事，敬請查參。

說明：

- 一、本組本（110）年2月24日經美字第1100000212號函諒達。
- 二、美商務部產業與安全局（BIS）本年3月11日發布預告略以，該局依據拜登總統本年2月24日簽署之14017號行政命令「美國供應鏈」（America's Supply Chains）應於100日內針對半導體製造及先進封裝供應鏈風險向總統提交報告，並提供解決風險之建言。另依據「2021年國防授權法」（NDAA 2021）第9904條「商務部對微電子技術現況之研究」（Department of Commerce Study on Status of Microelectronics Technologies in the United States）要求商務部長依據製造、設計與最終用途之全球性與供應鏈之相互依賴性，評估美國微電子產業基礎支撐國防之能力，該法亦要求商務部長向國會提交報告，內容包括潛在微電子生產中斷對關鍵技術領域造成之影響清單，以及微電子供應鏈脆弱性之斷層分析。商務部規劃先完

經濟部
國際貿易局

國際貿易局 110/03/12



1107007733

成14017號行政命令分析報告後，再視情況評估是否需更進一步資訊以完成NDAA 2021要求之分析報告。

三、有關評論之重點如下：

(一)評論期限：公告正式發布於聯邦公報後21日內提交（按，公告訂本年3月15日正式發布）。

(二)徵求評論要點包括但不限於：

- 1、半導體製造及先進封裝供應鏈中關鍵與不可或缺之商品與材料；
- 2、生產半導體所需之製造與其他能力，包括電子設計自動化軟體（electronic design automation software）及先進集成電路封裝技術與能力；
- 3、維持競爭性美國半導體生態所需之關鍵技能與人才，包括半導體製造所需之國內教育及製造技能、技能差距，以及滿足未來勞動力需求之任何機會；
- 4、可能中斷半導體供應鏈之風險或突發事件（包括國防、情報、網絡、國土安全、健康、氣候、環境、自然、市場、經濟、地緣政治、人權或強迫勞動風險）：
 - (1)依賴數位產品可能造成之失誤之風險；
 - (2)缺乏或未能發展國內製造能量所致之風險。
- 5、半導體供應鏈支撐國家與經濟安全及緊急應變之韌性與能力，包括：
 - (1)製造能力（包括滿足未來所需之現代化能力）；
 - (2)製造能力之差距，包括不存在德、受威脅的、單點故障，或單一或雙重供應者（single or dual suppliers）；
 - (3)關鍵製造與生產資產之所在地，以及對該等資產實際位置所帶來之風險；
 - (4)需透過不友好或不穩定國家獨家或主要提供關鍵或

經濟局

國際
騎縫章

不可或缺物品與原料；

(5) 關鍵或必要物品與原料之替代品或替代來源；

(6) 研發能量以維持領導力研發產品或半導體製造關鍵原料領導地位；

(7) 當前國內教育與製造勞動技能之差距、機會與潛在最佳實踐作法；

(8) 運輸系統對於支援半導體供應鏈之角色及該等運輸系統之相關風險；

(9) 氣候變遷對半導體製造之風險；

6、未能在美維持或發展半導體供應鏈對其他關鍵下游能力之潛在影響，包括糧食資源、公共事業、通訊技術、航空、人工智慧、5G基礎設施等；

7、政策建議；以及，

8、其他有助分析半導體產業供應鏈之資訊。

四、檢送前述預告如附件，併請卓參。

正本：經濟部國際貿易局

副本：經濟部、經濟部陳政務次長室(請經濟部代陳)、經濟部工業局

電子公文交換章
2021/03/12 10:10:05

國際
騎縫章